

Lasertec News 15

株 主 通 信 第 5 4 期 (2015年7月1日～2016年6月30日)

新中期経営計画 フェーズⅢ策定 新たなステージへ



Lasertec

新規事業へのアプローチ

レーザーテックの強みは、光応用技術をコアとした検査・計測に関する高い「技術力」と、市場やニーズに適応した製品を少人数かつ短期間で開発できる「開発力」にあります。

お客さまと密接にコンタクトを取ることでニーズをいち早くつかみ、お客さまからのご要望にスピーディーにおこたえすることで、顧客満足度を高め信頼関係を築いております。

これからも、高品質で高付加価値な製品を提供し、新しい市場を開拓してまいります。

Target



半導体ウェハ検査
(前工程)関連

2つのアプローチ

既存市場

新しく生まれる市場
(エマージング・マーケット)

- ▶ すでに存在している市場だが、半導体デバイスの微細化などにより、既存の製品や技術では対応できなくなった領域

製品例

リソグラフィ
プロセス検査装置
LX330



ウェハエッジ
検査装置
EZ300



マーケットサイズ

大手が対応し切れていない
ニッチ市場



テクノロジー

高い技術力が求められる市場
で、他社と差別化できる技術

- ▶ 新たな検査ニーズから生まれる新市場

半導体デバイスは性能向上やコストダウンのため、従来の微細化とは別に新たなプロセスや新構造、材料が採用され(例:3次元IC、SiCなど)、そのときに新市場が生まれます。

製品例

TSV裏面研磨
プロセス測定装置
BGM300



SiCウェハ欠陥
検査/レビュー装置
SICA88





2016年6月期(当期)は、新中期経営計画のフェーズⅡに入り、新規事業の基盤確立に努めました。また、長期的視点に立って事業を推進するため、新たなステージとなるフェーズⅢを策定し、今後はフェーズⅡとともにフェーズⅢの達成を目指してまいります。

レーザーテック株式会社 代表取締役社長

岡林 理

Q1

当期の業績についてどう評価されますか。市場環境と併せてお話しください。

A1

売上は前期比増収を達成し、利益額も高水準を維持することができました。当期の純利益に関しては、過去最高を達成しました。

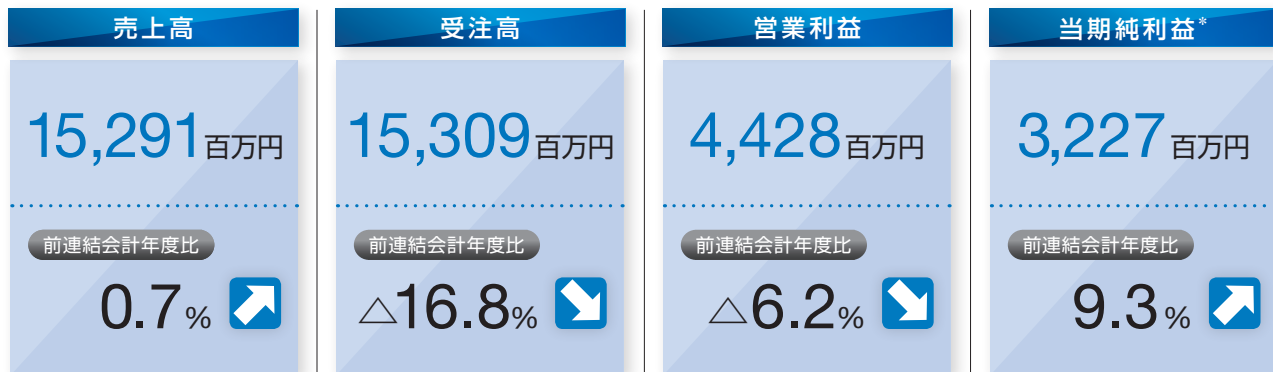
当社の主要販売先である半導体業界では、パソコンやタブレット端末向け半導体の需要が低迷し、スマートフォンの成長も鈍化していることから、ロジックメーカー、メモリーメーカーともに設備投資を抑制しました。そのような厳しい状況にある中、当社は主力製品である半導体マスクブランクス欠陥検査装置の販売に注力し、本製品の売上としては過去最高を記録することができました。また、FPD業界において、高精細な中小型液晶パネルおよび有機ELパネルに向けたフォトマスク用設備へ

の投資があり、高精細FPD用マスク欠陥検査装置は、前期に引き続き好調な業績を挙げることができました。

新規事業の半導体ウェハ検査関連では、当期に発表したSiCウェハ欠陥検査/レビュー装置の新製品SICA88が早くも売上に貢献しました。その他の半導体ウェハ検査関連製品でも着実にお客さまの評価、検討が進んでおり、新規事業の基盤が整いつつあります。

またFPD関連では、当期にFPD用マスクブランクス欠陥検査装置とFPD用マスク位相

連結業績ハイライト



* 親会社株主に帰属する当期純利益

差測定装置を開発し発売しました。

このような環境下、当期の業績は、売上高152億91百万円（前連結会計年度比0.7%増）、営業利益44億28百万円（同6.2%減）、経常利益45億75百万円（同1.2%減）、

親会社株主に帰属する当期純利益（以下純利益）32億27百万円（同9.3%増）となりました。純利益に関しては、過去最高を達成することができました。

Q2

当期は、新中期経営計画のフェーズⅡの初年度でした。フェーズⅡの進捗状況はいかがですか？

A2

継続的にコアビジネスの製品の競争力を高めるとともに、新規事業として半導体ウェハ検査関連事業の基盤確立を図りました。

当期は、半導体マスク欠陥検査装置において、欠陥検出感度と検査速度を向上させ、最先端の10nm～7nmノードに対応したモデルX810EXを市場投入しました。装置性能を向上

させ、国内および海外のサポート力、営業力を強化することで競争力を高め、10nmノード以降の市場でシェア増大を図っています。

今後の半導体マスク関連製品では、次世代



機の開発に注力するとともに、新しい露光技術である EUVL (Extreme Ultraviolet Lithography: 極端紫外線リソグラフィ) への対応を着実に進めてまいります。

半導体ウエハ関連製品では、当期にウエハエッジ検査装置 EZ300を開発し、ラインアップに加えました。フェーズIで発表し既に実績を

挙げてきたリソグラフィプロセス検査装置 LX330をはじめ、半導体ウエハ関連の検査・計測装置のラインアップを充実させ、今後の成長に向けた基盤づくりを進めます。

また将来の柱となる新規事業を見いだすべく、積極的に市場の新たなニーズを発掘していきます。

Q3

フェーズIIの後は、どのような展望をお持ちですか？

A3

長期的視点に立って事業を推進するため、フェーズIIが終了する2018年6月期以降を見据えたフェーズIIIを策定しました。

新たに2019年6月期からの3カ年をフェーズIIIと位置づけました。この期間(2018年7月～2021年6月)では、次世代のリソグラフィである EUVL が実用化される見通しであることから、大きなビジネスチャンスが生まれます。この時期に EUVL 関連の新製品や、育ててきた

半導体ウエハ検査関連事業を大きく業績へ貢献させることで、飛躍を目指してまいります。

地域では中国市場に着目します。SEMI*の予測では、2016年に中国市場が台湾に次いで2番目に大きな半導体製造装置(検査・計測装置含む)の市場になる見通しです。さらにその

後も大きな成長が見込まれており、今後中国が非常に重要な地域になることは確かだと思われます。当社は早くから中国市場で実績を

つくってまいりましたが、フェーズⅢの時期に中国市場で存分に活躍できるように、体制のさらなる強化を進めてまいります。

* 半導体製造装置、材料を中心とするエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際工業会

株主さまへメッセージをお願いいたします。

「当社の強さが発揮でき、我々が成長できる分野に経営資源を集中する」という基本方針のもと、新中期経営計画はスタートしました。「強さを発揮できる事業への選択と集中」、「強固な財務体質の構築」を推進したフェーズⅠから始まり、フェーズⅡで「コアビジネスの強化」と「新規事業の柱を一つ立ち上げる」を目標に掲げ実行してまいりました。フェーズⅢでは、フェーズⅡをさらに深化させコアビジネス、新規事業ともに強化してまいります。これらに関わる施策は順調に進捗しており、おかげさまで、

当期は純利益で過去最高の成績を達成することができました。このたび策定したフェーズⅢでは、今までの活動を結果に結びつけ、さらに大きく業績を伸ばしていく所存です。

レーザーテックはこれからも、世界中のお客さまへの貢献を通じて、真のグローバル企業としてその企業価値を高め、株主の皆さまのご期待におこたえしてまいりたいと存じます。今後とも、一層のご理解とご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

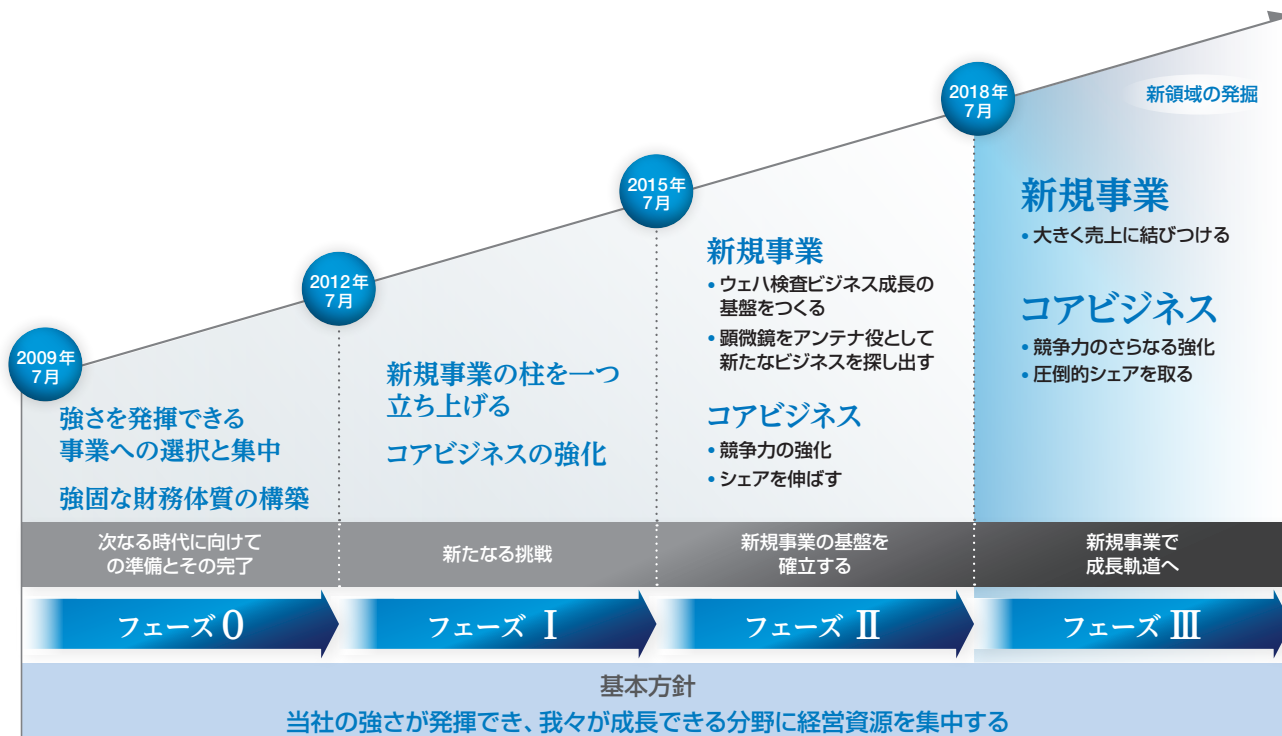


新中期経営計画

フェーズⅡから新たなステージフェーズⅢへ

このたび、新中期経営計画フェーズⅢ（2018年7月～2021年6月）を策定しました。AI（人工知能）やIoTなど技術革新に伴う半導体需要増の予測や、半導体次世代リソグラフィ技術（EUVLなど）の実用化を見据え、フェーズⅢでは**コアビジネス**（マスク関連製品、顕微鏡の強化）、**新規事業**（ウェハ検査、EUVL関連を大きく売上に結びつける）の2分野を軸として取り組んでまいります。また当社の強みを生かせる新領域の発掘（さまざまな業界と接点がある顕微鏡をアンテナとした新領域の発掘）も積極的に推進いたします。現在進行中のフェーズⅡでは足固めを行い、フェーズⅢで大きな飛躍を目指します。

レーザーテックは新中期経営計画のもと、独自技術の開発と高い利益率を維持し、質の高い成長を追求してまいります。



Topic 1

「第22回 半導体・オブ・ザ・イヤー2016」で SICA88が優秀賞を受賞

電子デバイス産業新聞が主催する「半導体・オブ・ザ・イヤー」は、最先端のIT機器・産業を支える半導体製品を表彰する賞です。第22回の本年は、2015年4月～2016年3月に発表された製品・技術（バージョンアップを含む）を選考対象とし、「開発の斬新性や量産体制の構築、社会に与えたインパクト、将来性」などを基準に記者投票により決定。応募製品多数の中、3部門で9製品が受賞しました。当社のSiCウェハ欠陥検査/レビュー装置SICA88は、開発着手から短期間で製品化されたことや、業界での高い貢献が評価され、半導体製造装置部門で優秀賞の受賞となりました。

これからも次世代技術や最先端分野での装置開発を行い、産業の発展に貢献したいと考えています。



「第22回 半導体・オブ・ザ・イヤー2016」受賞式

Topic 2

新製品紹介

近年、FPD業界ではスマートフォンに代表される高精細ディスプレイや、4K、8Kテレビへの対応が急務となっています。中でも「FPD用フォトマスク」「FPD用マスクブランクス」は高精細化に重要な役割を担っています。当社は今年3月に下記2製品を発表し、FPD用フォトマスクの品質向上や生産性向上に貢献しています。

新製品発売



2016年
3月

位相差測定装置
「MPM365gh」

半導体の業界標準機であるMPMシリーズのFPD用フォトマスク向け装置



2016年
3月

大型マスクブランクス
欠陥検査装置
「LBIS シリーズ L852 /
L1052」

高精細FPD用フォトマスク
製造の歩留まり改善に貢献

2016年6月期(第54期)の連結決算のご報告

連結貸借対照表(要約)

(百万円未満切り捨て)

科 目	当連結会計年度 (2016年6月30日)	前連結会計年度 (2015年6月30日)	科 目	当連結会計年度 (2016年6月30日)	前連結会計年度 (2015年6月30日)
資産の部			負債の部		
流動資産	18,799	16,299	流動負債	3,839	3,421
			固定負債	222	188
			負債合計	4,061	3,610
固定資産	7,070	7,322	純資産の部		
			株主資本	21,839	19,648
資産合計	25,870	23,621	純資産合計	21,808	20,011
			負債純資産合計	25,870	23,621

連結損益計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科 目	当連結会計年度 (自2015年7月1日 至2016年6月30日)	前連結会計年度 (自2014年7月1日 至2015年6月30日)
②売上高	15,291	15,187
売上原価	6,403	6,709
売上総利益	8,887	8,478
販売費及び一般管理費	4,459	3,755
③営業利益	4,428	4,722
経常利益	4,575	4,630
③親会社株主に帰属する当期純利益	3,227	2,953

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科 目	当連結会計年度 (自2015年7月1日 至2016年6月30日)	前連結会計年度 (自2014年7月1日 至2015年6月30日)
④営業活動による キャッシュ・フロー	3,083	1,032
投資活動による キャッシュ・フロー	△368	△82
財務活動による キャッシュ・フロー	△1,038	△611
現金及び現金同等物の 期首残高	6,537	6,120
現金及び現金同等物の 期末残高	7,967	6,537

決 算 の ポ イ ン ト

① 純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は、218億8百万円となりました。自己資本比率は84.2%で、引き続き財務の健全性を維持しています。またROE(自己資本当期純利益率)は、15.5%となりました。

② 売上高

マスクブランクス欠陥検査装置の売上が好調だったため、半導体関連装置の売上が前期に続き100億円を超え、売上高の増加に貢献しました。

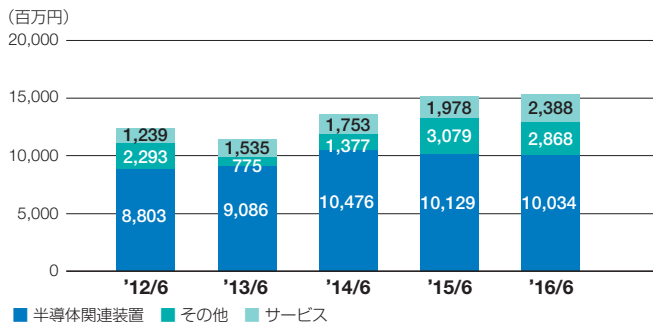
③ 利益

親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高となり、また、売上高、営業利益も過去2番目に高い業績となりました。

④ 営業活動によるキャッシュ・フロー

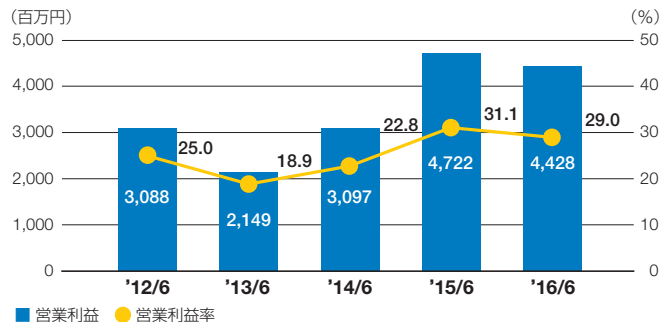
税金等調整前当期純利益、前受金の増加などの収入要因が、法人税等の支払い、たな卸資産の増加などの支出要因を上回りました。

製品別売上高

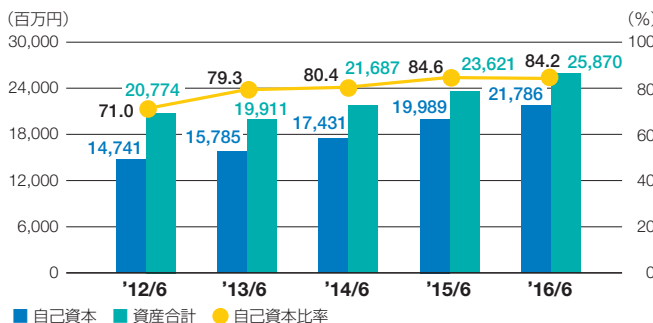


※2014年6月期より、従来のFPD関連装置およびレーザー顕微鏡の売上高は、その他とすることに変更し、2012年6月期以降の製品別売上高も遡及修正しています。

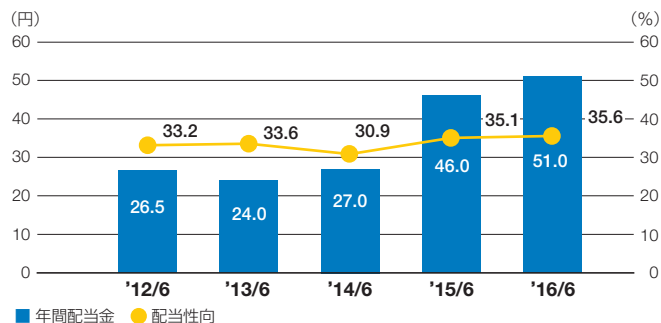
営業利益・営業利益率



自己資本・資産合計・自己資本比率

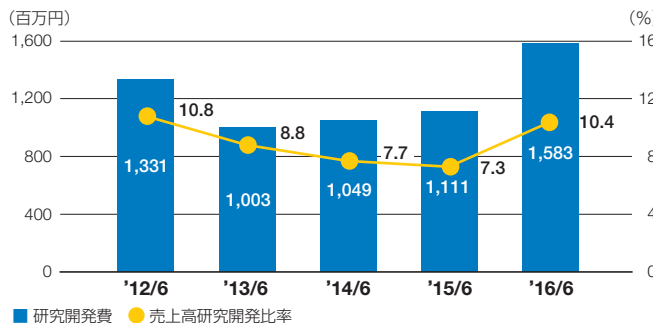


年間配当金・配当性向

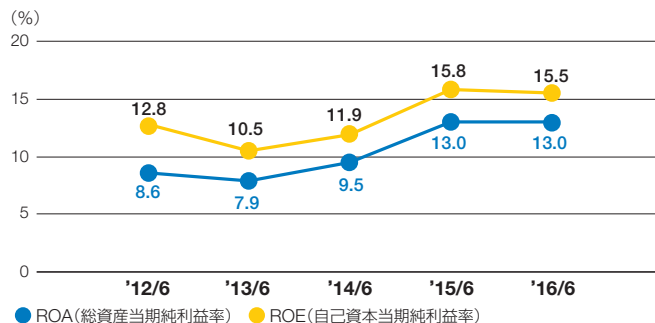


※2013年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。上記の数字は株式分割が2012年6月末時点で実施されたものとして計算したものです。

研究開発費・売上高研究開発比率



ROA・ROE



会社概要 (2016年6月30日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 264名 単体 196名

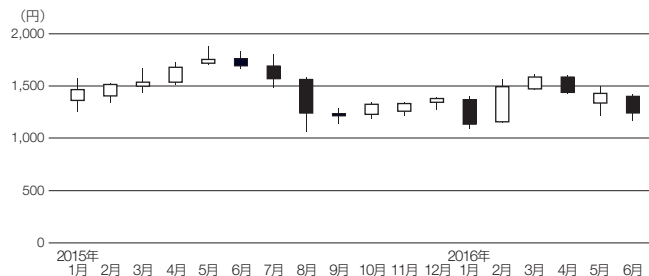
株式情報 (2016年6月30日現在)

株式概要

上場市場	東京証券取引所市場第一部(証券コード6920)
発行済株式総数	23,571,600株
株主数	5,107名
大株主一覧	
	所有株式数(株) 持株比率(%)
内山 靖子	1,001,600 4.24
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	912,500 3.87
内山 洋	870,800 3.69
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	811,600 3.44
株式会社三菱東京UFJ銀行	752,000 3.19
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE-HCR00	725,200 3.07
内山 秀	697,000 2.95
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	648,600 2.75
前田 せつ子	646,800 2.74
THE BANK OF NEW YORK 133522	536,200 2.27

(注)上記のほか、当社は発行済株式総数に対し、4.35%の自己株式を保有しています。

株価の推移



役員

(2016年9月28日現在)

代表取締役社長 岡林 理	社外取締役 梶川 信宏 海老原 稔 下山 隆之
代表取締役副社長 楠瀬 治彦	常勤監査役 塚崎 健明
常務取締役 内山 秀	監査役 古賀 一正 齋藤 侑二 石黒 美幸
取締役 森泉 幸一 関 寛和	

株主メモ

事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
基準日	毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)
単元株式数	100株
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座管理機関	
同連絡先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
公告掲載URL	http://www.Lasertec.co.jp

ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に登録された株式に関する各種手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店においても取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行の本店でお支払いいたします。

当社Webサイトのご案内

<http://www.Lasertec.co.jp>

当社Webサイトには、IR情報をはじめ各種情報が掲載されています。ぜひご覧ください。

